

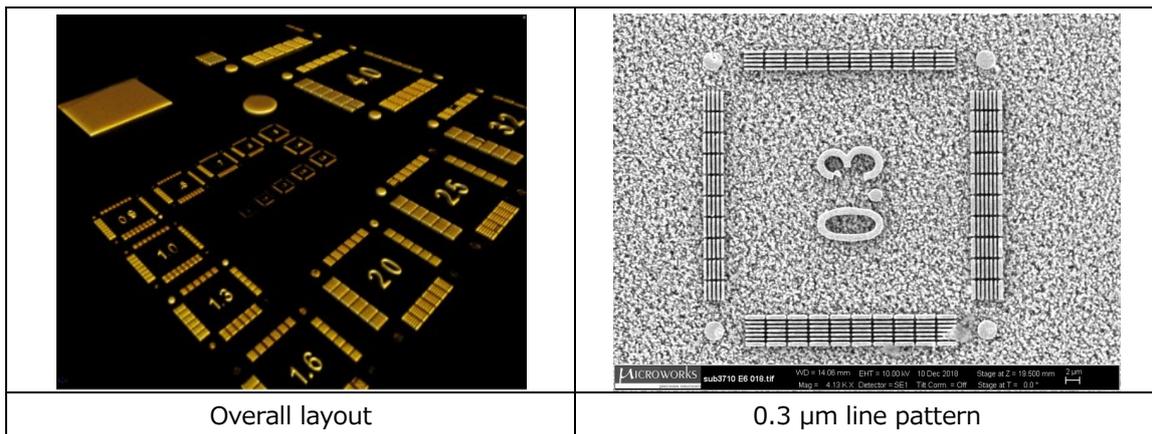


## 高コントラストのX線分解能ターゲットの商品化 Commercialisation of a High Contrast X-ray Test Target

microworks GmbH (ドイツ)は、Yxlon International (ドイツ)が同社と共同開発した、X線イメージング向けの分解能ターゲットを商品化いたします。最小幅 0.3  $\mu\text{m}$ 、厚さ 3  $\mu\text{m}$  以上の金をX線吸収材としているため、工業用X線イメージング検査システムの性能評価に大きく寄与するものと考えられます。

本製品の製造では、高アスペクト比パターンを加工することのできる、LIGA プロセス(X線リソグラフィと高精度電鍍を組み合わせたプロセス、下記 URL 参照)を使用しています。従来品のテストパターンで用いられているタングステンとは異なり、X線に対して高コントラストの金が採用されているため、高電圧X線管のマイクロ焦点を正確に評価することができます。

搭載される解像度ターゲットの構造サイズは、5  $\mu\text{m}$  から最小 0.3  $\mu\text{m}$  までの 17 段階です。



### テストターゲット仕様 / Test target specifications

<b>Outer dimension</b>	8 mm x 8 mm chip size
<b>Materials</b>	Substrate: 200 $\mu\text{m}$ thick silicon, Absorber: 3 $\mu\text{m}$ high gold
<b>L/S widths</b>	Tolerance: +/-10%
<b>Pattern period [<math>\mu\text{m}</math>]</b>	5.0, 4.0, 3.2, 2.5, 2.0, 1.6, 1.3, 1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.45, 0.4, 0.35, 0.3 (17 steps)

### リンク / Links

LIGA プロセス(超微細加工)

[www.asicon-tokyo.com/imt02.php](http://www.asicon-tokyo.com/imt02.php) (**Japanese**)

LIGA: microfabrication process

[www.asicon-tokyo.com/imt09.php](http://www.asicon-tokyo.com/imt09.php) (**English**)

国内代理店 / Local distributor

株式会社 ASICON / ASICON Tokyo Ltd.